



致 (To) : : 全体会员 (All Members)  
由 (From) : : 香港线路板协会 (HKPCA)

编号# : M-17-54  
日期 (Date) : 13-09-2017

**Laminate Technology dealing with stringent PCB demand on Compact Size  
and High Speed**

**PCB 尺寸密集化和高频化应用严格要求下的基板技术应用**

日期 Date:	2017 年 10 月 20 日(星期五) / October 20, 2017 (Friday)
时间 Time:	2:00-5:00 PM
地点 Venue:	东莞市柏宁长安国际酒店三楼宴会 1 号厅 东莞市长安镇德政中路 222 号
课程内容 Course Content:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 增强刚性以改善 CTE 和翘曲，从而获得更好的 DS 性能 Increase rigidity to control CTE and warpage for better DS performance</li> <li>2. 高频领域 Low Dk&amp;Df 背景下的树脂设计及超细表面粗糙度下的微蚀特殊设计，以期达到完美细线生产 Resin design for low Dk_Df - high speed application and special design of micro-etch for super surface roughness in order to get fine line fabrication</li> <li>3. 高模量封装材料（芯板）&amp;低模量 PP 复合使用，改善翘曲问题 high Modulus package materials (core) and low modulus PP for addressing warpage</li> <li>4. Low Dk&amp;Df 材料介绍 Introduction to Low Dk/Df materials</li> </ol>
课程目标 Training Objective:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 运用对化学材料特性认知的技术手段，来探索开发可以满足最新及未来发展要求的电子设备用基板材料 Laminate technology to fulfil latest electronic device requirement and deliver future development</li> <li>2. 运用上述理念开发具体应用的产品 Products with above technology for Specific Application</li> </ol>
培训对象 Target Audience:	PCB 工程师&主管 Process Engineers and production supervisors in PCB industry



<p>讲师简介 Introduction to speaker:</p>	<p>合津周治先生毕业于东京理科大学，获硕士学位。他在日立化成 CCL 研发事业部工作 17 年，一直致力于无卤及高频材料的开发，为日立化成电子材料（香港）有限公司及日立化成电子材料（广州）有限公司研发部领军人物。</p> <p>Mr. Shuji Gozu obtained a Master degree from Tokyo University of Science ,he has worked for 17 years at R&amp;D of CCL division in Hitachi. Mr. Shuji Gozu has specialized in developing Halogen free and high speed materials .He is the head of HCEM HK and GZ R&amp;D .</p>	
<p>语言 Language:</p>	<p>English with Mandarin translation /英语及普通话翻译</p>	
<p>费用 Fee:</p>	<p>本会会员—每位 HK\$370，或 RMB310（含税）：费用包括讲义、茶点，请于活动举行前办妥缴费事宜，<b>逾期作取消论</b>。如属同一公司多人报名，可获以下优惠（此优惠只限公司成员）： 3 人至 4 人—每位 HK\$320 或 RMB270（含税） 5 人或以上—每位 HK\$250 或 RMB210（含税） 非本会会员—每位 HK\$570 或 RMB480（含税） *费用包括讲义、茶点。</p> <p>HKPCA Members - HK\$370, or RMB310 per head (tax included): The fee includes handouts and refreshments. Please settle the payment before the event, or the reserved seats will be cancelled. If more than one people of the same company signed up for the training, group discount will be offered (For corporate members only): 3 to 4 persons- HK\$320 or RMB270 per head (tax included) 5 or more persons - HK\$250 or RMB210 per head (tax included) Non-members - HK\$570 or RMB480 per head (tax included): *The fee includes handouts and refreshments.</p> <p><b>备注：汇款请注明 8 月培训费。不设现场收费，烦请于课程开始前 3 天付清。如在截止日期后，已报名之人士需作取消，费用将不作退还。</b></p>	
<p>缴款办法 Payment Method</p>	<p>人民币电汇： 户名： 港粤线路板科技咨询（深圳）有限公司 开户行： 招商银行股份有限公司深圳常兴支行 帐号：7559 1878 8810 201 深圳秘书处地址： 中国广东省深圳市南山区桃园路 171 号 深圳平安银行（原深圳发展银行）南山大厦 13A2 室</p>	<p>港币电汇： 银行名称：香港上海汇丰银行有限公司 账户名称：香港线路板协会有限公司 帐户号码：469-089601-838 银行电汇编号：HSBCHKHHHKH 香港办事处地址：香港九龙观塘 成业街 7 号宁晋中心 22 楼 B 室 Bank name : HSBC Bank A/C Name : Hong Kong Printed Circuit Association Ltd. Bank A/C No: 469-089601-838 Swift Code: HSBCHKHHHKH Hong Kong Office Address: Unit B, 22/F., Legend Tower, 7 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, H.K.</p>



<p>截止日期 Deadline:</p>	<p>2017 年 10 月 17 日 (星期二) /October 17,2017 (Tuesday)</p>
<p>查询 Enquiry:</p>	<p>深圳秘书处: 陆小姐 Lily Lu; Tel#: (86) 755 8624 0033; Email ID:<a href="mailto:lilylu@hkpc.org">lilylu@hkpc.org</a> 袁小姐 Susan Yuan; Tel#: (86) 755 8624 1673; Email ID:<a href="mailto:susanyuan@hkpc.org">susanyuan@hkpc.org</a></p>
<p>地图 Map:</p>	



## 回条 Reply Form

### 2017 年 10 月份培训课程

日期: 2017 年 10 月 20 日 (星期五) / 时间: 14:00 - 17:00

地点: 东莞市柏宁长安国际酒店三楼宴会 1 号厅

### 参加者详情:

人数	参加者姓名(必填)		职位	参加培训者	是否需要 培训证
	英文	中文		手机号(必填)	
1					
2					
3					
4					
5					
6					

### 说明:

- 1、需要培训证的学员请在「是否需要培训证」一栏中进行选择，并填妥中英文名，无中文名的除外。
- 2、培训证将在当次培训课程结束后，发放给学员本人；若参加者有变动请于截止日期前通知本会。

对是次课程之期望 ( 请务必填写 ) : \_\_\_\_\_

费用 ( 备注: 不设现场收费, 烦请于课程至少三天前付清 ) :

参加人数共 \_\_\_\_\_ 人 x 每人港币/人民币 \_\_\_\_\_ = 合共总额港币/人民币 \_\_\_\_\_

### 联络人信息:

姓名: \_\_\_\_\_ 电话号码: \_\_\_\_\_

公司名称: \_\_\_\_\_

公司地址: \_\_\_\_\_

电邮地址: \_\_\_\_\_ 传真号码: \_\_\_\_\_

**\*\*\*截止报名日期: 2017 年 10 月 17 日(星期二)\*\*\***